

Willkommen bei O-Leading

Wir sind professionell **Leiterplattenhersteller** mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Produktpalette - Einzel, Doppel Seite, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir bieten schnellen Prototypenservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Arbeitsstunden der Produktionszeit.

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDESTENS .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTOPFT WERDEN

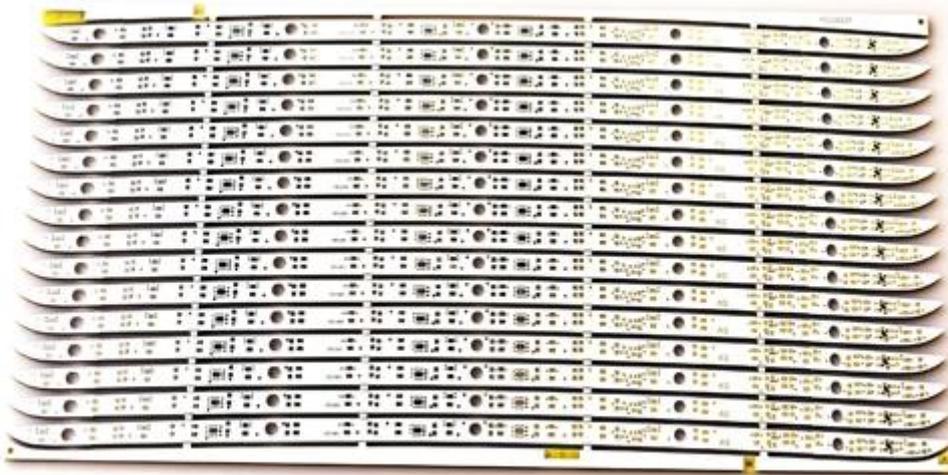
Packen Sie mit farbloser transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stück / Beutel, geben Sie das Trockenmittel in die Flanke und legen Sie die Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite (**OEM-Leiterplattenhersteller**)

Produktbeschreibung

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führen
Basismaterial	FR-4, Aluminium, Rogers, schweres Kupfer usw.	Kupferdicke	0,5 Unzen-5 Unzen
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenveredelung	Immersion Gold / Zinn / Silber, OSP, bleifreies HASL	Brettstärke	0,1-5 mm
anwendbar auf	Eis, Mobiltelefon, Klimaanlage, Waschmaschinen	Charakter	Industriesteuerungsplatine
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	Kundenanforderung
Gewicht	0,01 kg - 5 kg	MOQ	10 Stück
Farbe	blau, rot, grün, schwarz.gelb	Minch Zeilenabstand	0,2 mm
Modellnummer	leiterplattenbestückung leiterplattenhersteller	Preis	\$ 0.1 - \$ 10
Design-Typ	Kundenanforderung	Größe	0,01 m3 bis 10 m3



www.o-leading.com



www.o-leading.com

Unser Team



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine

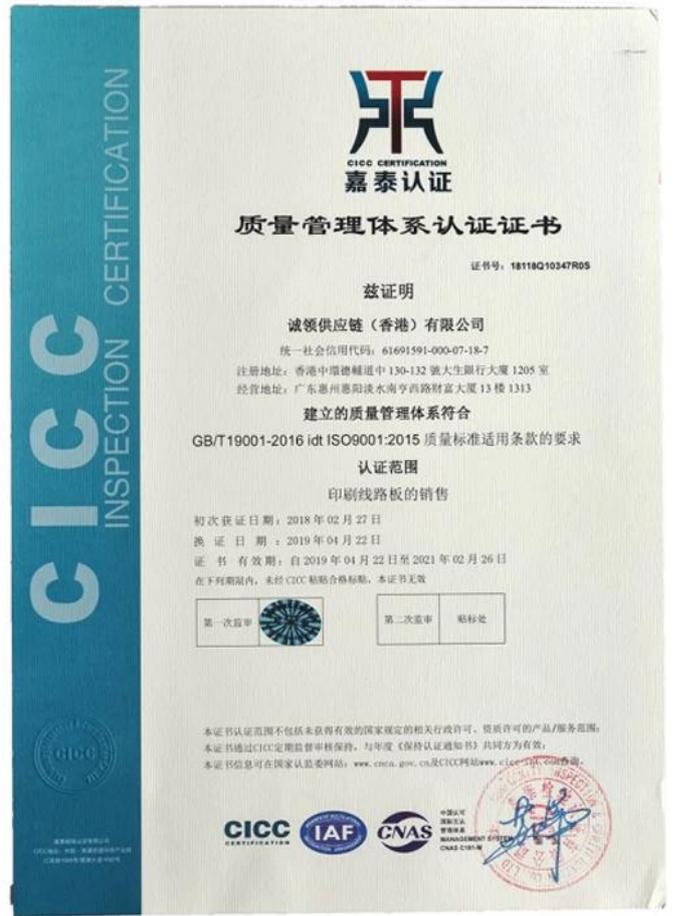


E-test Machine

Factory SMT



Zertifizierungen





ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD
 ROOM 1205, 12/F
 TAI SANG BANK BLDG
 130-132 DES VOEUS ROAD
 CENTRAL, HONG KONG

E490354

Type	Cond Width		Cond Thk	SS/ DS/ DSO	Max	Max		Meets	C		
	Min	Edge			Area	Solder	Oper			Flame	
	mm(in)	mm(in)	mic(mil)		Diam	Limits	Temp	Class	UL796	T	
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Prozessfähigkeit

PCB-Produktionsmöglichkeiten

Schicht Anzahl: 1Layer-32Layer

Fertige Kupferdicke: 1 / 3oz-12oz

Min. Linienbreite / interner Abstand: 3,0 mil / 3,0 mil

Min. Linienbreite / Abstand extern: 4.0mil / 4.0mil

Maximales Seitenverhältnis: 10: 1

Brettstärke: 0.2mm-5.0mm

Max Panel Größe (Zoll): 635 * 1500 mm

Mindestbohrlochgröße: 4mil

Plated Hole Tolerance: +/- 3mil

Blind / Buried Vias (All-Typen): JA

Via Fill (leitend, nicht leitend): JA

Basismaterial: FR-4, FR-4high Tg. Halogenfreies Material, Rogers, Aluminiumbasis,Polyimid,
Schweres Kupfer

Oberflächen: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Versilberung,Immersiondose, Goldfinger, Kohletinte

SMT-Produktionsmöglichkeiten

Leiterplattenmaterial: FR-4, CEM-1, CEM-3, Leiterplatte auf Aluminiumbasis
Maximale Leiterplattengröße: 510 x 460 mm
Min PCB Größe: 50x50mm
PWB-Stärke: 0.5mm-4.5mm
Brettstärke: 0.5-4mm
Min. Komponentengröße: 0201
Komponente mit Standardchipgröße: 0603 und größer
Maximale Höhe der Komponente: 15 mm
Min. Steigung: 0,3 mm
Min. BGA-Kugelpitch: 0,4 mm
Platzierungsgenauigkeit: +/- 0,03 mm